創新資訊應用展示暨研討會

The AI Nexus：
智鏈賦能・驅動未來

中華軟體公會今年首度打造大型AI解方博覽會，以AI技術、創新應用與多元產業需求，展示最新解決方案，串聯政府與產業交流媒合，共創智慧未來。

展示地點

主場·台北
10/30（五）
09:30–16:00
臺大醫院 國際會議中心
2F 201-205

巡迴·高雄
10/23（五）
13:30–17:00
亞灣新創園區
3F 基隆+台中港

巡迴·台中
11/06（五）
13:30–17:00
思享空間
2F 201-203

觀展贈好禮



展會亮點

AI解方展示
30+ AI 廠商齊聚，
一次掌握創新應用與科技趨勢。

四大展區探索
不只「AI智慧應用」！一次掌握「資安雲端」、「智慧治理」、「創新應用」多元解方。

論壇實績分享
熱門議題 × 實務案例
掌握資安、AI及數位轉型新趨勢。

逛展集點好禮
逛展集點・好禮加碼！走訪攤位完成集點，抽大獎再享精美好禮！

公務人員專屬

 # 公務人員學習時數
主場提供8小時；中南部提供4小時學習時數

論壇勤學禮
事前報名並參與論壇，
主場前100名 / 中南部場前50名，
即贈7-11 50元商品卡！

主場限定 **專屬媒合禮** 公務人員(含國營事業單位)限定

7-11 200元禮券

預約媒合｜完成即享媒合禮
公務機關與會者可於活動前預約，活動當天完成媒合即可獲贈媒合禮。

活動產品搶先報

活動窗口｜
黃資深專員
07-338-0948
abby.huang@tissa.org.tw

立即報名參觀

主辦單位 中華民國資訊軟體服務商業同業公會 Taiwan Innovative Software and Services Association TISSA

贊助夥伴 SUSE ShareTech

與您相約，一同開創AI新未來！